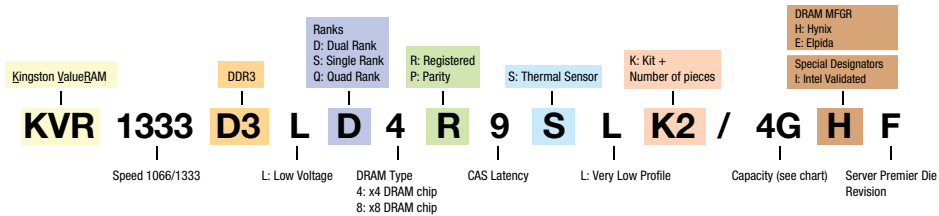




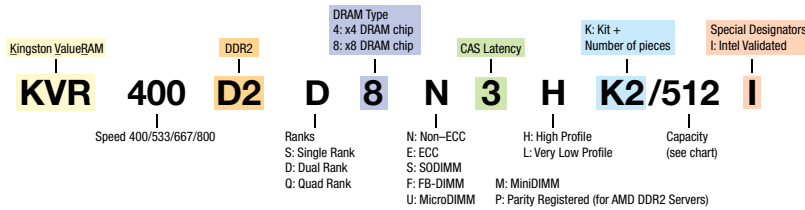
Маркировка модулей памяти ValueRAM

Данное справочное руководство предназначено для того, чтобы оказать помощь при выборе модулей памяти ValueRAM® на основании их технических характеристик. В данном документе представлено большинство наших основных модулей памяти, однако их названия могут отличаться. На оборотной странице представлено краткое описание терминов, которые используются для описания данных модулей памяти, созданных на базе отраслевых стандартов.

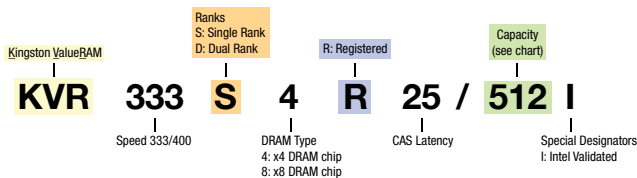
DDR3 for Desktops and Servers (PC3-8500, PC3-10600)



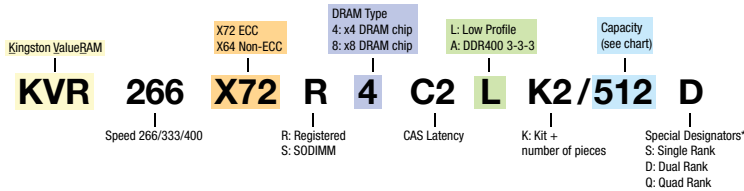
DDR2 for Notebooks, Desktops, and Servers (PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400)



DDR for Servers (PC2700, PC3200)

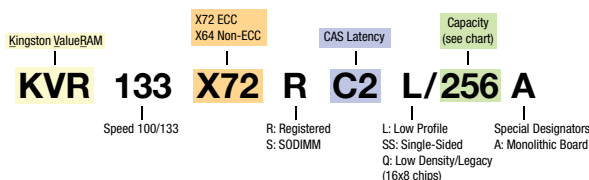


DDR for Notebooks, Desktops, and PC2100 Servers (PC2100, PC2700, PC3200)



* For server memory, if an S/D/Q designators is not shown, please check product list for ranks.

SDRAM for Notebooks, Desktops, and Servers (PC100, PC133)



[Подробнее >>](#)



Module Capacities Currently Available

256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
-------	-------	-----	-----	-----	-----	------

For more information, please visit:
valueram.com

Модули памяти DRAM x4 и x8

Модули памяти Registered DIMM для серверов могут иметь 4 ("x4") или 8 ("x8") чипов DRAM. 8-чиповые серверные модули памяти, как правило, имеют более низкую стоимость, но только 4-чиповые модули памяти могут поддерживать такие функциональные возможности, как коррекция ошибок в несколько бит (multiple-bit error correction), технология Chipkill, Memory Scrubbing и Intel Single Device Data Correction (SDDC).

Модуль X64

Модуль памяти без буферизации и без кода коррекции ошибок с 64-битной шириной пропуска данных.

Модуль X72

Модуль памяти без буферизации с кодом коррекции ошибок ECC или модуль памяти Registered DIMM (с технологией ECC). Модули с технологией ECC имеют 72-битную ширину пропуска данных (64 бита данных + 8 бит ECC).

Емкость

Общее количество ячеек памяти, содержащееся в модуле памяти, выраженное в мегабайтах или гигабайтах. Для комплектов емкость указывается как общая емкость всех модулей памяти, включенных в комплект.

Задержка сигнала CAS

Один из ключевых показателей задержки (указывается в тактовых циклах), когда данные становятся доступными в модуле памяти. После загрузки команды чтения или записи, а также адресов строки/столбца задержка сигнала CAS предоставляет время ожидания (окончательное), необходимое для подготовки этих данных к записи или чтению.

DDR2

Второе поколение технологии производства модулей памяти DDR. Модули памяти DDR2 не имеют обратной совместимости с модулями памяти DDR из-за разницы в значениях напряжения (1,8 В против 2,5 В), различных конфигураций выводов и несовместимой технологии производства чипов.

DDR3

Третье поколение технологии производства модулей памяти DDR. Модули памяти DDR3 не имеют обратной совместимости с модулями памяти DDR из-за разницы в значениях напряжения (1,5 В), различных конфигураций выводов и несовместимой технологии производства чипов.

Плотность

Синоним термина "Емкость"; как правило, используется в отношении чипов DRAM.

Технология ECC (код коррекции ошибок)

Данная технология представляет собой метод проверки целостности данных, которые хранятся в модуле DRAM. Она позволяет находить ошибки длиной в несколько бит и находить и исправлять ошибки длиной в один бит.

FB-DIMM (Fully Buffered DIMM)

Серверные модули памяти следующего поколения, которые включают в себя буферный чип Advanced Memory Buffer, расположенный в модуле, который предназначен для соединения двух высокоскоростных последовательных соединений с контролером памяти.

Intel Validated (проверено Intel)

Оборудование, которое имеет подобную маркировку, было проверено лабораторией корпорации Intel для подтверждения совместимости с серверными платформами Intel.

Kit (комплект)

Комплект, который включает в себя несколько модулей памяти. K2 = комплект из двух модулей.

Устаревший модуль памяти (или модуль памяти с низкой плотностью)

Данный термин относится к модулям памяти, которые предназначены для установки в старые системы, например, необходимо использовать модули памяти SDRAM объемом 128 Мб, если контроллер памяти не поддерживает модули памяти SDRAM объемом 256 Мб.

Ранк: 1-ранковые, 2-ранковые и 4-ранковые модули памяти

Необходимо учитывать этот показатель при установке модулей памяти в рабочие станции и серверы. Если общее число ранков превышает допустимое для системной памяти количество ранков, то может произойти следующее: система не загрузится, возникнут ошибки памяти, система не сможет определить полный объем доступной памяти. Воспользуйтесь руководством пользователя для вашей системы, чтобы узнать поддерживаемое количество ранков памяти.

Registered DIMM

Модуль памяти, содержащий одну или несколько микросхем регистров, используемых для передачи и синхронизации адресных и управляющих сигналов от контроллера памяти системной платы, и микросхему замкнутой петли фазовой автоподстройки частоты (PLL), используемую для передачи синхросигналов материнской платы на все микросхемы DRAM. В большинстве платформ для рабочих станций и серверов используются Registered DIMM. Некоторые серверы начального уровня и рабочие станции поддерживают только Unbuffered DIMM. Воспользуйтесь руководством пользователя для вашей системы, чтобы получить сведения о типе необходимых модулей памяти.

SODIMM

Малогабаритный модуль памяти с двухрядным расположением выводов. Модуль памяти уменьшенного форм-фактора, предназначенный для использования в мобильных ПК и других компактных устройствах.

Частота

Скорость передачи данных или тактовая частота, которую поддерживает модуль памяти.

Server Premier

Серверная память с полностью контролируемой спецификацией используемых материалов (BOM), начиная с PCB и заканчивая ревизией кристалла микросхемы.

